

产品说明书

InFORMS®

增强型复合焊料

简介

InFORMS®是矩阵结构的增强型复合焊料。这个工艺制造出一种增强型的焊料结构，不仅提高了强度，还能形成稳定一致的焊接厚度。一致的焊接层能最大化焊点的热导和机械可靠性，因此能确保最终焊点的高可靠性。

钢泰公司能提供各种形状InFORMS®（包括正方形、圆盘形和定制形状）来满足特定应用的需求。

特点

与传统焊料合金或者钢箔、钢片、钢带或者大型预成型焊料相比，InFORMS®的操作方便程度被大幅度提升。InFORMS®在提高张力和基板材料的耐压强度的同时，还能保持外层金属的独特属性（如柔软度、导电性能以及钢的其他优点）。

应用

InFORMS®为工程师们提供了一种开发新应用或者改进原有应用的增强型材料。这种材料适用于不同材料的热膨胀系数（CTE）高度不匹配的应用，或者对热导和机械可靠性要求很高的应用。其中一个例子就是IGBT模块生产中把DBC焊接到底板上应用。InFORMS®可用多种合金制造，来满足特定产品的需求。

尺寸

InFORMS®可采用大多数预成型焊片的规格制造。此焊料内部的复合结构不会影响形位公差。下表列出了此产品的集中标准规格。

标准规格

描述	支撑材料高度	预成型焊片要求	
		部件尺寸 (x & y)	部件尺寸 (z)
LM04	0.004"	>0.4" /每边	>0.006"
LM06	0.006"	>0.4" /每边	>0.008"
LM08	0.008"	>0.4" /每边	>0.010"
SM04	0.004"	>0.1" 且 <0.4" /每边	>0.006"
ESM03	0.003"	>0.030" 且 <0.100" /每边	>0.005"

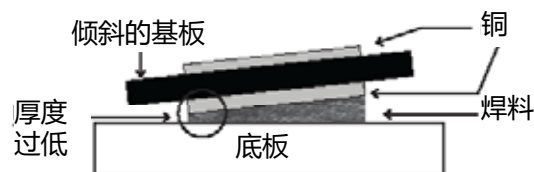
我们也提供：预成型焊片、焊锡线、焊锡带、焊锡膏、焊锡球、助焊剂和其他形式的产品。

安全说明书

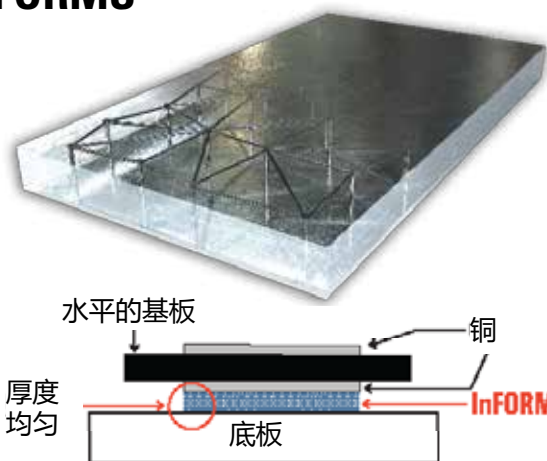
如欲获取本产品的安全说明书，敬请访问：<http://www.indium.com/sds>。

挑战

IGBT模块中，基片和底板之间不平的焊接层导致了在薄的地方的应力集中，如下图所示：



解决方案 InFORMS®



小结

InFORMS®是具有增强型矩阵结构的预成型焊片，这种矩阵结构不仅能提高焊料强度，还能提供可靠的支撑高度。这些优势结合起来可提高很多电子元件的可靠性和性能。

本产品说明书仅供参考，并不对所描述的性能做任何担保。具体质保信息请参见产品合同、发票或者发货单里的文字说明。除特别说明，钢泰公司的产品和解决方案均市场有售。

立即联络：china@indium.com

更多详情：www.indium.com

中国 +86 (0) 512 628 34900 • 亚洲 +65 6268 8678 • 欧洲 +44 (0) 1908 580400 • 美国 +1 315 853 4900

表格编号：99297 (SC A4) R1



©2017 Indium Corporation